附件

成都高新技术产业开发区

关于支持集成电路产业高质量发展的若干政策

（征求意见稿）

为深入贯彻落实产业建圈强链，增强成都高新区集成电路产业核心竞争力，促进产业加快聚集、提质升级，实现高质量发展，打造具有影响力的特色产业基地，特制订本政策。

第一章 适用范围和原则

本政策适用于登记注册、税收关系均在成都高新区，具有独立法人资格，从事集成电路设计、制造、封测、设备（零部件）、材料、工业软件研发制造等业务的企事业单位及机构（行业协会、民非组织）；以及在成都市范围内与高新区合作共建的园区（以下简称合作园区）从事集成电路设备（零部件）、材料研发制造等业务的企业。本政策适用的企事业单位应管理规范，无不良信用记录，自觉遵守安全生产、环境保护等方面的法律法规，近三年未发生重大安全事故。

第二章 集成电路设计政策

第一条 支持企业提升研发设计能力。对设计企业租用本地研发或国家级公共服务平台提供的EDA工具的，按照租赁费用的50%给予最高100万元补贴。对设计企业使用多项目晶圆（MPW）进行集成电路产品研发流片的，按照流片费用70%给予最高500万元补贴。

第二条 支持企业加强生态合作。对和本地晶圆代工厂合作开发工业软件、IP核的企业，按照企业自投项目研发费用的10%给予最高200万元补贴**。**对设计企业开展有利于促进本地集成电路线宽小于45nm（含）工艺产线应用的首轮全掩模工程流片项目，按照流片费用50%给予最高2000万元补贴，后续批量生产流片按照流片费用5%给予3年每年最高500万元补贴。。对设计企业使用本地封装测试服务的，按照封测费用较上一年费用增量的15%给予最高100万元补贴。

第三章 晶圆制造、封装测试政策

第三条 支持企业加大项目投入。对新引进的总投资5亿元以下集成电路晶圆制造、封测项目以及实施生产线技术升级改造的本地集成电路企业，且固定资产投资超1000万元的，按照固定资产实际投资额8%给予最高2000万元补贴，单个项目补贴额最高不超过4000万元。对特别重大的项目，按“一事一议”原则给予支持。

第四条 支持企业制造、封测服务能力提升。对晶圆制造企业为本地设计企业提供流片代工服务的，按照代工费用的8%给予最高1亿元补贴。对已量产的封测企业为本地设计企业提供先进封装及高可靠性封装测试服务的，按照封装测试费用的5%给予最高500万元补贴；对新投产的先进封装及高可靠性封装产线，按照服务订单费用的10%给予最高500万元补贴。

第四章 设备（零部件）、材料政策

第五条 加快上下游供应链项目落地。对高新区新落地或开展技术改造以及高新区协同引进、落地合作园区的设备（零部件）、材料等配套企业，且固定资产投资超500万元的，按照固定资产投资额10%给予最高1000万元补贴，单个项目补贴额最高不超过2000万元。对特别重大的项目，按“一事一议”原则给予支持。

第六条 支持设备、材料验证应用。对集成电路企业协助本地及合作园区企业开展自主安全可控设备（零部件）、材料等配套产品相关验证的，按照验证费用的50%给予补贴，单台设备验证最高不超过100万元，每批材料验证最高不超过50万元，每家企业最高不超过1000万元。对集成电路设备（零部件）、材料企业产品进入国内外知名企业进行验证的，按不超过进场验证费用的20%给予补贴，给予最高500万元补贴。对本地及合作园区企业成功研制首台套（首批次）并实现销售的，按照产品实际销售总额的30%给予最高3000万元奖励。

第七条 支持供应链协同。对集成电路企业首次采购本地及合作园区企业设备（零部件）、材料、工业软件等产品形成供应链的，按照购销合同总额的10%（供需双方各5%）给予最高500万元补贴；金额持续增长的，按照购销合同总额的5%（供需双方各2.5%）给予最高500万元补贴，单个企业补贴额每年最高不超过2000万元。

第五章 产业人才引育政策

 第八条 支持企业聘任关键人才。对IC设计企业人力资源成本支出超过50万元的，制造、封测、设备（零部件）、材料企业人力资源成本支出超过30万元的，按照人才使用效能，分梯度给予企业每人每年最高50万元，用于人才绩效奖励。

第九条 加快紧缺适用型人才培养。对本地企业主导与国际国内高校、科研院所共建集成电路人才实训基地的，按照企业建设投入费用的20%给予基地最高500万元的一次性补贴。对本地晶圆制造、封测企业招用应届毕业生并提供6个月以上工艺技术带教培训的，按照培训结束后企业实际留岗人数给予5000元/人最高200万元补贴，用于企业人才培养；给予带教导师1万元/年的带教补贴。对本地企业委托专业培训机构开展工程师技术能力提升培训的，按照企业实际支付培训费用的20%给予最高50万元的培训补贴。

第六章 产业生态跃升政策

第十条 支持企业做大做强。对IC设计企业年度主营业务收入首次突破1亿元、3亿元、5亿、10亿的，按照晋档补差原则给予500万元、700万元、900万元、1100万元一次性奖励；对晶圆制造、封装测试企业年度主营业务收入首次突破3亿元、5亿元、10亿元、20亿元的，按照晋档补差原则给予500万元、700万元、900万元、1100万元一次性奖励；对设备（零部件）、材料企业年度集成电路相关主营业务收入首次突破5000万、1亿、3亿、5亿的，按照晋档补差原则给予500万元、700万元、900万元和1100万元一次性奖励。鼓励企业将以上奖励资金部分用于对企业核心管理人员、研发人员等有突出贡献人员的个人奖补。

第十一条 培育本地隐形冠军。对首次通过“国家鼓励的重点集成电路设计企业”备案的，给予100万元一次性奖励。对首次获评国家级制造业单项冠军示范企业、产品的集成电路企业，分别给予100万元、50万元一次性奖励。对首次获评国家级专精特新“小巨人”企业、省级专精特新企业的集成电路企业，分别给予50万元、30万元一次性奖励。

第十二条 支持高水平创新平台建设。对新获批集成电路领域省级及以上制造业创新中心、产业创新中心、技术创新中心的，给予最高1000万元一次性奖励。对有持续投入的国家级创新平台，按照平台设备及软件购置费用的30%给予最高500万元补贴。

第十三条 支持企业开展关键技术攻关。对承担国家集成电路领域重大项目、重大技术攻关计划和重点研发计划的，根据项目国拨资金到位进度，按照1:0.5比例给予最高2000万元的配套资金支持。。

第十四条 鼓励企业通过资质认证。对首次通过AEC-Q认证、ISO26262等车规级标准认证的，按照认证费用的30%给予30万元/个一次性奖励。对首次通过车规级芯片测试认证的平台，给予50万元/个一次性奖励**。**对设备（零部件）、材料企业产品通过SEMI标准认证的，按照认证费用的50%给予最高100万元/个一次性奖励。单个企业每年最高奖励200万元。

第十五条 促进行业资源整合。对高校、科研院所将仪器设备等科学装置开放给本地集成电路企业使用的，按照服务费用的20%给予最高300万元奖励，鼓励将以上奖励资金部分用于对运营团队的个人奖补。对服务本地集成电路产业，推动区域产业竞争力及行业影响力提升的行业组织，给予每年最高不超过150万元奖励。

第七章 附则

第十六条 政策解释。本政策实行预算管理和总量控制。本政策与其他政策相重叠事项按照就高不重复原则执行。已享受“一企一策”相关政策的企业不再重复享受此政策类似条款。

本政策属于《成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策》的成都高新区配套政策，与市级政策类似条款（第一条、第二条），经审核认定，超出市级支持的部分由成都高新区给予支持。

本政策由成都高新区管委会负责解释，具体实施细则由成都高新区电子信息产业局制定。

第十七条 有效期限。本政策自2024年xx月xx日起执行，有效期3年。在国家、省、市相关政策有重大调整时，根据实际情况调整。